

模組板

関連技術

- 多層基板技術
- 多層基板技術
- フレキシブル基板技術
- 柔性基板技術
- 埋め込みコンポーネント技術
- 嵌入式元件技術
- パワーエレクトロニクス技術
- 電力電子技術

日文

関連技術

(中文) 相關技術

主な種類（機能）

- 通信モジュール基板
- 通信模組基板
- 電源モジュール基板
- 電源模組基板
- センサーモジュール基板
- 感測模組基板

日文

モジュール基板

(中文) 模組板

將電子機器或系統中具有特定功能的電路或元件集成在一起的基板。

モジュール基板

模組板

電子機器やシステムの中で特定の機能を持つ回路や部品を集積した基板。

日文

モジュール基板メーカー

(中文) 模組板製造商

主なメーカー

- ユニマイクロン（台湾）
- 欣興電子
- 金像電子（中国）
- 金像電子
- サムスン電子（韓国）
- 三星電子
- TTMテクノロジーズ（米国）
- TTM科技
- 台湾積体電路製造（台湾）
- 台灣積體電路製造

日文

通信モジュール基板

(中文) 通信模組基板

説明

無線通信やネットワーク通信を担当する回路を集約した基板。

集成了負責無線通信或網路通信電路的基板。

解説

模組板

- 電源モジュール基板（電源模組基板）

電源供給に関する回路が集積されている基板

集成了與電源供應相關的電路的基板。

- センサーモジュール基板（感測模組基板）

各種センサー（温度、圧力、湿度など）の回路が組み込まれている基板。

集成了各種感測器（如溫度、壓力、濕度等）的電路的基板。

- 多層基板技術（Multilayer PCB Technology）（多層基板技術）

複数の導体層を積み重ねて製造するプリント基板（PCB）の技術。

將多層導電層疊加製作的印刷電路板（PCB）技術。

- フレキシブル基板技術（Flexible PCB Technology）（柔性基板技術）

柔軟性を持つ基板を用いて、曲げやねじりに対応できる回路を実現する技術。

使用具有柔性特性的基板，實現可以彎曲或扭曲的電路技術。

- 埋め込みコンポーネント技術（Embedded Components Technology）（嵌入式元件技術）

基板内部に電子部品を組み込む技術。

將電子元件集成在基板內部的技術。

- パワーエレクトロニクス技術（Power Electronics Technology）（電力電子技術）

高い電力を扱う電子機器において、電力の変換、制御、供給を行うための技術。

處理高電力的電子設備中，進行電力轉換、控制和供應的技術。